

300mmウェーハ対応のダイボンダー、出荷300台を達成

－ルネサス東セミ製の半導体組立装置－

2005年5月20日

株式会社日立ハイテクノロジーズ（執行役社長：林 将章／以下、日立ハイテク）は、当社が販売を行っている株式会社ルネサス東日本セミコンダクタ（社長：笠木 理／以下、ルネサス東セミ）製の300mmウェーハ対応のダイボンダーについて、このたび累計出荷台数300台を達成しました。

ダイボンダーは半導体組立のダイボンディング工程で使用され、ダイシングされたウェーハからチップを取り出し、リードフレームや基板などのインターポザーに搭載する装置です。

ルネサス東セミは、1998年に他社に先駆けて300mmダイボンダーを世界市場に投入し、日立ハイテクは、ルネサス東セミの協力の下、主に韓国、台湾組立メーカーのメモリ組立用に販売を行っています。汎用性のある一般的な銀ペーストを用いたフェイスアップ構造のエポキシダイボンダー（DBシリーズ）、およびLOC/BOC（Lead/Board-On-Chip）構造のCSPダイボンダー（CMシリーズ）の2機種をラインアップしており、共に高生産性、高安定性が市場から高く評価されています。特にDRAMパッケージの主流であるLOC/BOC用CSPボンダーは現在80%以上（当社推定）の世界シェアを獲得しています。

デジタル機器の小型、高機能化により1つのパッケージ内に複数チップを内蔵するSiP（System in Package）、MCP（Multi Chip Package）の需要が拡大しており、それらの大半がチップ積層型の構造となっています。パッケージの高さ制限から1個当たりのチップ厚は50μm以下となりますが、ルネサス東セミはこの極薄チップの搭載技術においても先行しており、一部の顧客では既に量産ラインで採用されています。

日立ハイテクは、半導体後工程も戦略市場と捉え、SiP、WLP（Wafer Level Packaging）等の先端パッケージニーズに応えるべく、ルネサス東セミとの強力な販売体制により、ダイボンダーを中心にビジネスの拡大を図っていきます。



CSPダイボンダー「CM-700」

CSPダイボンダー「CM-700」の製品詳細情報

お問い合わせ先

お問い合わせ頂く前に、当社「[個人情報保護について](#)」をお読み頂き、記載されている内容に関してご同意いただく必要があります。当社「[個人情報保護について](#)」をよくお読みいただき、ご同意いただける場合のみ、お問い合わせください。

お問い合わせ先

半導体製造装置営業統括本部 先端製品営業本部 アセンブリ装置部
担当：星 TEL：03-3504-5157

報道機関お問い合わせ先

社長室 広報・IRグループ
担当：塩澤 TEL：03-3504-5637